



硅晶体管对管系列产品

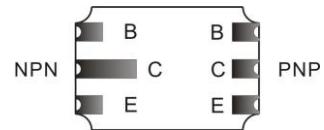
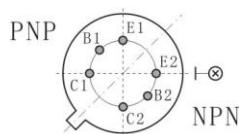
2N4854V 型硅 PNP/NPN 高频小功率开关晶体管对管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 T0-78 型金属封装和 LCC-6 型金属陶瓷封装。器件具有特征频率高、开关时间小、体积小、重量轻，可靠性高的特点。器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V，T0-78 封装典型重量 0.90g，LCC-6 封装典型重量 0.156g。



TO-78 型



LCC-6 型

注：LCC-6 封装产品型号后缀加“U”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+：Q/RBJ1026QZ, QZJ840611；

JP、JT、JCT：Q/RBJ21025-2005, GJB33A-1997；

ASTY (T0-78 型)：ASTYPS0202/0045-2015, GJB33A-1997；

YB、YC (T0-78 型)：Q/QJA 20104/322-2021, Q/QJA 20104A-2017。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	P_{tot1}^a mW	P_{tot2}^b mW	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	I_{CM} A	T_{stg}, T_j °C
2N4854V	300×2	1000×2	75	70	4	0.5	-55~150

^a P_{tot1} 是指 $T_A=25^\circ\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_A>25^\circ\text{C}$ 时，单管按 2.4mW/°C 线性地降额，双管按 4.8mW/°C 线性地降额。

^b P_{tot2} 是指 $T_C=25^\circ\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_C>25^\circ\text{C}$ 时，单管按 8mW/°C 线性地降额，双管按 16mW/°C 线性地降额。

4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

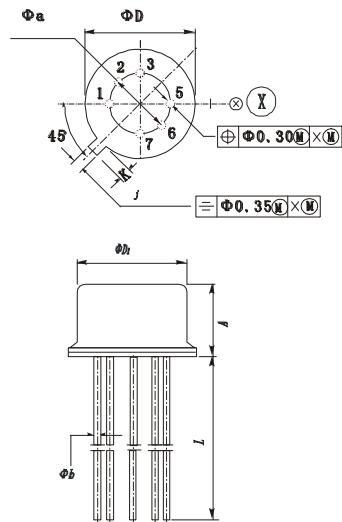
参 数		数 值			单 位
符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	
$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_C=0.1\text{mA}$	70	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	$I_E=0.1\text{mA}$	4	—	—	V
I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$	—	1	5	μA
I_{CEO}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$	—	2	10	μA
I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=2\text{V}$	—	2	10	μA
h_{FE}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	40	—	150	—
两管 $ \Delta h_{\text{FE}}/h_{\text{FE}} $ ^a	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	—	10%	—
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$	—	0.7	0.9	V
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$	—	0.2	0.4	V
f_T	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=30\text{MHz}$	120	150	—	MHz
t_{on}	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	30	60	ns
t_{off}	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	250	300	ns

^a 除 $|\Delta h_{\text{FE}}/h_{\text{FE}}|$ 外，本表中参数为每个单管的电特性。



硅晶体管对管系列产品

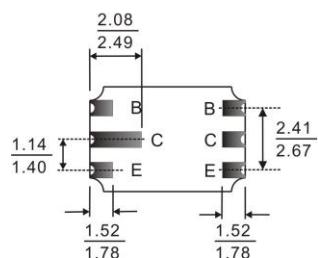
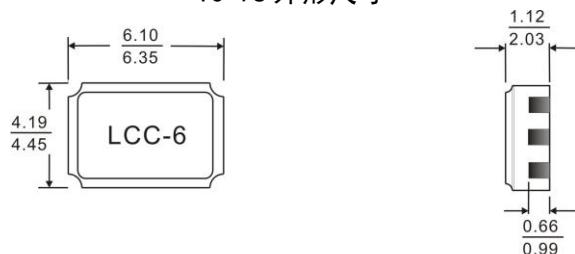
5、外形尺寸



单位为毫米

尺寸符号	最小值	最大值
A	4.20	4.70
Φ_a	—	—
Φ_b	0.407	0.508
ΦD	9.45	9.80
ΦD_l	8.01	8.50
j	0.712	0.863
K	0.740	1.14
L	12.5	25.0

T0-78 外形尺寸



单位为毫米

LCC-6 外形尺寸

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，从而影响其密封性。

安装焊接时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。